

陶瓷电容失效分析试验，不锈钢303盐雾试验标准

产品名称	陶瓷电容失效分析试验，不锈钢303盐雾试验标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

陶瓷电容失效分析试验，不锈钢303盐雾试验标准

沾锡能力测试参考标准IPC J-STD 002D，使用Solder globule wetting balance方法进行。测试参数如表1所示：

连接器正反面引脚的沾锡能力测试结果如图3，从测试曲线上看，引脚上锡良好，可焊性未发现明显异常。

焊点IMC分析

选择不良产品上的正常焊点进行切片和SEM+EDS分析，通过观察焊点IMC的生长状况，确认焊点内部润湿状况，及焊接热量是否正常。从结果上看，连接器焊点生成了连续的且厚度正常的Ni₃Sn₄IMC层，即焊点内部润湿良好，焊接热量正常。故初步排除焊接热量对此案不良现象的影响。

锡膏品质分析

本案例中使用的锡膏为千住K2V锡膏，通过测定其扩散性来验证锡膏的润湿品质状况。扩散性参考标准JIS-Z-3197 8.3.1.1进行，将适量的锡膏试样放置在铜板上，加热一定时间使其熔化，待冷却凝固后测量锡膏的尺寸来计算得出锡膏的扩散率。具体的计算方法如下： $SR = (D - H) / D * 100$ 其中，SR----扩散率（%）
H----扩散凝固后的锡膏高度D----扩散凝固后的锡膏直径（把扩散凝固后的锡膏假定为球体， $D = 1.24V^{1/3}$ ）

